

Title (en)

METHOD FOR INJECTION MOLDING WITH IMPROVED MOLD PRIMER.

Title (de)

SPRITZGIESSVERFAHREN MIT VERBESSERTER FORMGRUNDIERUNG.

Title (fr)

PROCEDE DE MOULAGE PAR INJECTION ET COUCHE D'APPRET AMELIOREE UTILISEE A L'INTERIEUR DU MOULE.

Publication

EP 0288457 A1 19881102 (EN)

Application

EP 86905055 A 19860804

Priority

US 8601581 W 19860804

Abstract (en)

[origin: WO8800876A1] An in-mold primer which contains a preferentially adhesive resin also serves simultaneously as a mold release agent, and results in RIM (reaction injection molding) plastic articles whose surfaces virtually mirror the mold surface. Such a primer leaves no appreciable residue whatsoever on the mold surface during a production run of a large number of articles, obviating the previously encountered need to clean the mold each time a conventional mold release agent was introduced, each time an article was molded. The preferred resin in the primer is a hydroxylated vinyl chloride-vinyl acetate copolymer (VAGH resin).

Abstract (fr)

Une couche d'apprêt utilisée à l'intérieur du moule et contenant une résine de préférence adhésive sert également simultanément d'agent de démolage et permet d'obtenir des articles en plastique obtenus par moulage à injection par réaction (RIM) dont les surfaces reflètent virtuellement la surface du moule. Une telle couche d'apprêt ne laisse aucun résidu notable sur la surface du moule durant un cycle de production d'un grand nombre d'articles, le nettoyage du moule à chaque introduction d'un agent de démolage traditionnel lors du moulage d'un article n'étant plus nécessaire. La résine préférée contenue dans la couche d'apprêt est un copolymère d'acétate de vinyle-chlorure de vinyle hydroxylé (résine VAGH).

IPC 1-7

B28B 7/36

IPC 8 full level

B29C 39/12 (2006.01); **B29C 33/58** (2006.01); **B29C 33/62** (2006.01); **B29C 37/00** (2006.01); **B29C 45/00** (2006.01); **B29C 45/37** (2006.01); **B29C 67/24** (2006.01)

CPC (source: EP)

B29C 33/62 (2013.01); **B29C 37/0032** (2013.01); **B29C 67/246** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

WO 8800876 A1 19880211; EP 0288457 A1 19881102; EP 0288457 A4 19880823; JP H01500984 A 19890406

DOCDB simple family (application)

US 8601581 W 19860804; EP 86905055 A 19860804; JP 50442486 A 19860804